

【東京/武蔵村山】品質保証リーダー候補　◆ヤマハ発動機グループ

ヤマハロボティクス株式会社での募集です。 品質管理・品質保証（技術系）のご経験...

募集職種

人材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名
ヤマハロボティクス株式会社

求人ID
1594516

業種
電気・電子・半導体

雇用形態
正社員

勤務地
その他東京

給与
450万円 ~ 750万円

勤務時間
08:45 ~ 17:30

休日・休暇
【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 採用月に応じて2日 ~ 15日 4か月目から 【休日】完全週休二日制...

更新日
2026年11月01日 00:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル

英語レベル
日常会話レベル

日本語レベル
ネイティブレベル

最終学歴
専門学校卒

現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2335254】
■組織構成：組織：品質保証部
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

■業務内容
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

品質不具合対応、再発未然防止、信頼性評価など、品質保証業務全般を担当いただきます。
1.市場および自社内品質不具合の一次故障解析と再発・未然防止実施までのフォローアップ
2.監査を含む協力会社（日本国内および海外サプライヤ）の品質管理

3.新規開発品の品質・信頼性評価およびDR（デザインレビュー）を含む開発ゲート管理
4.品質情報のデジタル化推進およびデータ活用による品質改善
5.品質マネジメントシステム（QMS）の更新・維持・管理

■半導体ボンディング装置のパイオニア企業

1970年代後半、それまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。競合が増えた今、当社の強みは品質No.1であり仕様に沿ってカスタマイズ設計ができること。この丁寧さは今後も捨てずに、日本企業としての自信・自負をもって世界No.1であり続けるのが私たちの目標です。

[取扱い製品】
ワイヤボンダ、ダイボンダ、バンプボンダ、フリップチップボンダ、等

□主力製品「フリップチップボンダ」について

半導体製造のための精密ロボットです。
ウェハー上に形成された半導体素子を、反転（フリップ）させて基板上
もしくはウェハー上へボンディングする為の装置で、従来のワイヤボンディングに
替わる新しい実装技術になります。
最新のスマートフォンやデータセンタの中心的な役割を果たすICを
製造する為の装置です。
メカトロニクス技術はもちろん、制振制御、ロボティクス、材料工学、
画像処理技術などあらゆる最先端の技術がつまっています。

スキル・資格

■必須（主務クラスに求めている内容）
・機械系メーカーでの品質保証経験
・以下のいずれかのご経験
　故障解析 ~ 再発・未然防止/サプライヤ管理/信頼性評価/DR/品質情報管理のDX化/QMSの維持管理

■尚可（主務クラスに求めている内容）
・マネジメント経験や社内および協力会社への品質改善指導経験

会社説明

ヤマハロボティクス株式会社（Yamaha Robotics Co. Ltd.）は、ヤマハ発動機株式会社グループにおいて半導体製造装置（後工程）および電子部品組み立て装置事業を担う会社です。